

Silspher D22 硅微粉

产品简介

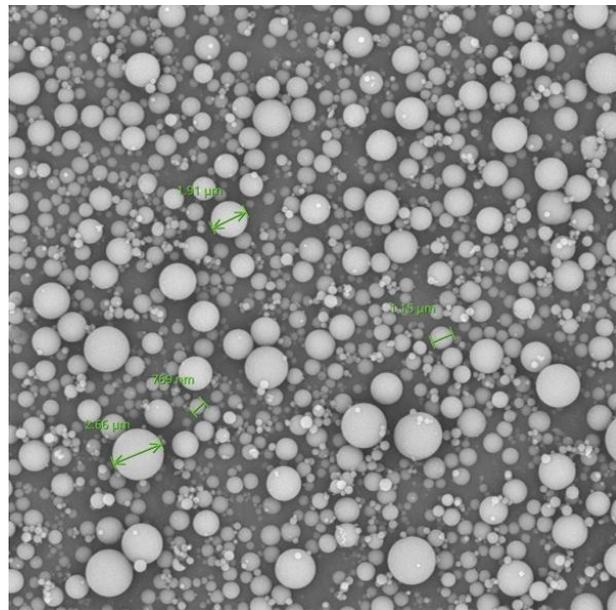
本品是以联锴粉体独有的制造技术加工而成的球形无机硅微粉，经过合成、高温煅烧、超细分级等工艺制造而成。

产品特点

- (1) 纯度高、球化率高、粒度小、分布窄、填充率高。
- (2) 高温煅烧，拥有良好的电绝缘性、耐高温性、耐磨性，化学稳定性。
- (3) 低热膨胀、低应力、低介电、低杂质离子，适用于电子封端材料。
- (4) 球形度高，流动性绝佳。

技术指标

指标性能	特征值
形貌	球形
SiO ₂ (%)	≥99.0
粒径 D50 (um)	2±0.5
粒径 D97 (um)	4±1.0
比重 (g/cm ³)	1.0
吸油量(ml/100g)	90-130
比表面积 m ² /g	200
干燥失重 (%)	≤0.2
pH	7.0-9.0
白度	≥90



应用领域

- (1) 覆铜板、电子灌封胶、LED 及电子封端填料。
- (2) 油墨、薄膜、末涂料和密封胶等工业行业。

推荐用量

总配方量 1%-80%，由于不同的配方和条件，建议用户在使用前进行试验，确定最佳的添加量。

储存条件

- (1) 常规 25kg/桶，也可根据客户要求作个性化定制。
 - (2) 应当常温干燥，密封储存，防潮防湿。
 - (3) 本品在干燥阴凉环境下储存，正常条件下保质期 12 个月。
- 本说明供参考使用，不具任何保证性

江西联锴化学有限公司

了解更多产品请登录网站: <https://industry.kingpowder.com/>

服务热线: 销售 19079738129 王先生
技术 15779682532 刘工